

## 求人情報

企業コード:114 ジョブコード:20231019-257-01-170

マネージャーレベル

ポジション名	[23-0528]半導体材料開発(有機、高分子、プロセス)【WEB面接可】
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート (リクルートエージェント / Recruit Agent)
企業名	ダイキン工業(株)
掲載開始・更新	2024-05-09 / 2024-05-09
職種	メディカル/医薬/バイオ/素材/食品 - 製品開発
業種	産業機器・重電・設備メーカー
勤務地	アジア 日本 大阪府
仕事内容	<p>新たな成長フェーズに入った半導体市場で微細加工プロセスにおける材料開発に携わっていただきます。</p> <p>【詳細】 ■当社の持つフッ素技術だけでなく、非フッ素材料を用いたリソグラフィ工程(パターンニングなど)の材料提案、プロセス開発、評価まで一貫して開発を実施し、顧客提案まで持って行くことがミッションとなります。 ■微細加工プロセス材料開発から、パッケージング含めた後工程材料開発など、これまで半導体プロセスでは使用されなかった新材料の探索にも携わっていただきます。</p>
企業について(社風など)	<p>■空調/冷凍機、化学、油機、特機、電子システムを展開。住宅やオフィス、工場や空港、病院、厨房を含む特殊空間への空調システム、空気清浄機向け高性能フィルタ、1,800種類以上のフッ素化合物等を手掛けています。</p> <p>従業員数 80369名</p>
応募条件	<p>【必須】 ■専攻学科：工学系 ■英語の文章を読んで理解し、簡単なメールの作成が可能 目安としてはTOEIC500点程度以上</p> <p>■下記何れかの実務経験10年程度</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●半導体製造プロセスにおける、有機・高分子材料開発を行ってきた中堅技術者</li><li>●フォトレジストなどリソグラフィ工程材料の開発経験者</li><li>●成膜評価、パーティクル管理、熱分析、機械強度、信頼性評価の経験</li></ul>
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢 (日本語能力試験1級又はN1)
年収	日本・円 500万円 ~ 900万円
休日	年間休日 124日
契約期間	正社員